



左向欣

ID:55175401

目前正在找工作 13276717737 345074235@qq.com  
男 | 29岁 (1988年9月6日) | 现居住 杭州-滨江区 | 6年工作经验

最近工作 (2年 1个月)

最高学历/学位

职位: 嵌入式软件工程师 专业: 电子信息工程  
公司: 软通动力信息技术集团有限公司 学校: 合肥师范学院  
行业: 计算机软件 学历/学位: 本科

个人信息

户口/国籍: 安庆  
身高: 172cm 婚姻状况: 已婚  
政治面貌: 中共党员

目前年收入: 30 万元 (包含基本工资、补贴、奖金、股权收益等)

求职意向

关键字: 硬件 嵌入式软件 MCU软件  
期望薪资: 20000-24999元/月 地点: 杭州  
职能/职位: 嵌入式软件开发(Linux/单片机/PLC/DSP...) 电子软件开发 业务 仪器仪表/工业自动化 (ARM/MCU...) 嵌入式软件工程师  
到岗时间: 1个月内 工作类型: 全职  
自我评价: 熟练掌握C和C++, 熟悉8位单片机的汇编语言程序设计和C语言程序设计流程, 熟悉32位单片机的开发流程, 对数字电路和模拟电路有一定的了解, 有3年的单片机独立产品开发经验, 对硬件有一定的了解, 熟悉SPI I2C RS232 RS485 ADC DAC等, 熟悉STM32单片机开发流程, 熟悉zigbee, wifi等相关嵌入式产品开发, 熟悉TI 多核cpu dsp侧和arm侧开发, 熟悉makefile, linux底层, shell脚本的编写, 能够适应快节奏的开发工作, 能够吃苦耐劳, 有较强的沟通能力, 分析能力和问题的解决能力, 能够较好的对问题进行总结, 具有良好的学习能力, 有一定的创新性。

工作经验

2016/6-至今 软通动力信息技术集团有限公司 (2年 1个月)  
计算机软件 | 500-1000人 | 民营企业

hw2012实验室 5G 嵌入式软件工程师  
研究部

工作描述: 1.基于TI 多核cpu arm侧和dsp侧平台代码开发。  
2.UA5.0编译系统开发, 用makefile和shell脚本实现自动化编译。  
3.IPC通信接口dsp侧和arm侧读写寄存器接口开发。  
4.uboot和ubi系统移植。  
5.iot小终端底层uart spi i2c nor flash接口驱动开发。  
6.熟悉modbus通信协议。

2015/5-2016/6 浙江风向标科技有限公司 (1年 1个月)  
互联网/电子商务 | 150-500人 | 创业公司

产品开发部 嵌入式软件开发(Linux/单片机/PLC/DSP...)

工作描述:	公司是专注与物联网平台建设，为企业提供智能化解决方案，为终端用户提供智能化生活解决方案。我主要从事智能产品接入开发工作，将客户产品通过wifi，zigbee等方式接入我们的云平台。主要参与产品，香薰机，报警主机，门磁，门铃，电动窗帘，空气电台，空气质量检测仪，空气净化器，等产品的应用开发工作。涉及到的模块有TI的CC2530模组，MTK的7681，乐鑫ESP8266模块，澜起的M05B模块等
2012/7-2015/5	杭州晶华微电子有限公司 (2年 10个月 ) 仪器仪表/工业自动化   50-150人   外资(非欧美)
技术部	嵌入式软件工程师
工作描述:	主要从事单片机项目的应用和公司芯片生产的测试工作，单独开发项目，包括硬件设计和软件的编写。工作主要参与项目如下：  1.从事公司生产芯片应用计量插座，电压电流表项目的软件编写和硬件的设计。公司应用上面主要是基于PIC单片机内核的汇编语言程序设计。硬件上面主要是电源电路，主要是阻容降压和开关电源电路设计，利用DXP软件进行PCB layout的设计等。  2.利用基于MFC的c++控件开发相关软件进行公司芯片前期的测试工作，熟练掌握C语言和C++相关语言程序设计，具有良好的编程习惯和撰写相关文档流程的习惯。  3.利用STM32单片机进行公司芯片的自动化测试项目，熟练产品集成自动化测试流程。  4.对硬件接口SPI I2C RS232 RS485 DAC ADC有一定的了解。  5.由于做应用比较多，经常和客户打交道，具有较强的沟通能力和分析问题，解决问题的能力。  6.能够适应快节奏的工作，能够吃苦耐劳，具有良好的学习能力和创新能力。  7.参与合作项目电子式电能表固件的开发工作，对cortex M3 cortex M0内核的MCU进行项目的开发，主要参与项目公司无线抄表工具的固件开发，以及一些海外的预付费单相表，三相表的固件开发工作，熟悉STM32系列单片机，熟悉IAR，Keil编程环境。对单片机外围电路以及对相关硬件有一定的了解，熟悉SPI，IIC，UART相关单片机接口电路。对电能表整个生产过程有了深入的了解，和公司硬件组，上位机组，测试组配合完成整个电能表项目的开发工作。
项目经验	
2016/6-至今	5g预言项目
所属公司:	软通动力信息技术集团有限公司
项目描述:	从事5g预言项目平台侧开发，主要是基于ti多核dsp芯片开发平台侧代码，具体内容包括整个平台makefile的实现，dsp与arm通信接口开发，底层uart spi驱动开发，ue硬件环境搭建等
责任描述:	具体内容包括整个平台makefile的实现，dsp与arm通信接口开发，底层uart spi驱动开发，ue硬件环境搭建等
教育经历	
2007/9-2012/7	合肥师范学院
本科   电子信息工程	
专业描述:	主要课程为数字电路 模拟电路 微机原理 单片机 电子CAD EDA技术 自动控制原理 c语言程序设计 数字信号处理 通信原理 信号与系统 matlab设计  电磁场与电磁波 微波技术 高频电路 电路分析基础等
技能特长 （包括IT技能、语言能力、证书、成绩、培训经历）	
▲技能/语言	
英语 <div><div></div>良好</div>	
▲证书	
2012/4	大学英语四级 （430）
2010/6	校一等奖学金
2009/6	张应友张陈雪娟奖学金

2009/6 全国计算机二级C语言 (笔试84机试100)

2008/6 国家励志奖学金 (专业课成绩年级第一)

▲ 培训经历

2012/3-2012/6 java软件工程师

培训机构: 蓝桥计划

培训地点: 合肥

培训描述: 熟练掌握corejava, javaee, mysql数据库  
html, css, ajax, javascript, 以及三大架构



xiangxin,zuo

ID:55175401

🚩 I'm looking for jobs now

📠 13276717737

✉ 345074235@qq.com

👤 Male | 29 Years old (1988.9.6) | Living in Hangzhou-Binjiang | 6 Years

Basic Info.

Hukou/Nation: Anqing

Height: 172cm

Marital Status: Married

Political Status: Party Member

Current Annual Income ¥ 30 (\*10K) (Including basic salary,subsidy,bonus,ROE,etc)

Job Preferences

Target Salary: ¥ 20,000-24,999 Month

Location: Hangzhou

Function/Position: Embedded Software Engineer

Industry:Electronics/Semiconductor/IC

(Linux/SCM/PLC/DSP...)

Internet/E-commerce

Electronics Software

Instrument/Industry Automation

(ARM/MCU...)

Duty Time: within 1 month

Job Type: Full-time

Skills & Speciality (Including IT skills、languages、certifications and trainings)

▲ Skills/Languages

English Good

▲ Certifications

2012/1 CET4 (430)